

国元证券股份有限公司

关于安徽耐科装备科技股份有限公司

2023年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责耐科装备上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作的情况

序号	项目	持续督导工作情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	本持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、不定期回访等方式，对公司开展持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	本持续督导期间，公司未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	本持续督导期间，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形。除上述事项外，本持续督导期内，公司及相关当事人未出现其他需报告的违法违规、违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。

7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构已督促公司依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	公司内控制度符合相关法规要求，本持续督导期间，公司有效执行了相关内控制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构已督促公司严格执行信息披露管理制度，经核查，其向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在公司不予更正或补充而应向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件进行了审阅，不存在公司不予更正或补充而应向上海证券交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	本持续督导期间，公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，保荐人应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	本持续督导期间，公司未出现该等事项。

16	<p>制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起15日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。</p>	<p>本持续督导期间，公司不存在需要专项现场检查的情形。</p>
----	--	----------------------------------

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司可能存在的相关风险如下：

（一）核心竞争力风险

1、技术开发与创新风险

公司属于智能制造装备行业的细分领域，主要产品为半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备。随着我国对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，智能制造装备行业正处于快速发展阶段，能否不断推进产品的技术升级，能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是公司能否保持持续竞争力的关键。

若公司不能顺应产业发展趋势作出正确的研发方向判断，在技术水平、研发能力等方面持续提升竞争力，则将面临技术升级的风险；若公司在板级、晶圆级封装设备研发方面进度迟缓，将对公司拓展板级、晶圆级等先进封装设备市场产生负面影响；如公司不能及时满足市场需求，不断研发新技术、新产品，则公司实现未来战略规划目标具有不确定性。

2、关键技术人才流失和不足的风险

随着公司业务规模的不断扩大，公司对关键技术人才需求日趋旺盛。未来，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，或者公司人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行，公司将无法引进更多的关键技术人才，甚至可能出现关键技术人才流失、储备不足的情形，对公司未来可持续发展产生不利影响。

3、核心技术泄密风险

经过多年的技术积淀，公司掌握了一系列核心技术，为公司的持续发展注入了源动力。虽然公司制定实施了保护核心技术的制度和措施，公司核心技术对公司控制生产成本、改善产品性能和质量以及保持公司市场竞争力至关重要。但是如果因相关人员信息资料保管不善、关键技术人员流失或在生产经营过程中相关技术、数据、图纸、保密信息泄露等导致核心技术泄密，将可能对公司未来的生产经营和发展产生一定不利影响。

(二)经营风险

1、市场竞争风险

随着国家对智能制造装备行业的重视程度和支持力度的持续增加，我国智能制造装备行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务等方面的优势逐渐显现。智能制造装备市场的快速增长以及我国市场的国产化率提升的预期，吸引了国外行业巨头和国内有实力的智能制造设备商参与竞争。在半导体封装设备领域，已经成为通富微电、华天科技、长电科技等封测龙头企业的设备供应商，但与国际行业巨头相比仍处于竞争劣势。在塑料挤出成型设备领域，总体规模、资金实力、销售团队、市场占有率、产品认可度等方面仍存在一定的差距；若公司不能抓住国家政策的支持和行业发展带来的机遇，不断提升自身的技术水平并加强市场开拓，更有效地参与市场竞争，将会对公司的长远发展产生不利影响。

2、部分原材料依靠外采的风险

报告期内，公司存在部分客户指定原材料的情况，主要指定德国和奥地利生产的模具钢材，对该类原材料存在重大进口依赖，在客户不指定的情况下公司也有国内模具钢材供应商，所生产的产品符合欧盟产品标准；为使公司半导体封装设备产品的稳定性及可靠性更高，在目前境外进口相关原材料未受到限制的情况下，公司塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备使用的传感器、工控机、控制器、电磁阀等，公司半导体封装设备中使用的轴承、导轨、伺服电机、控制系统等零部件主要采购于日本品牌供应商（部分品牌在国内有生产工厂），公司也有国内供应商替代方案；公司半导体封装设备目前使用的PM23钢、PM60钢主要采购于瑞典的模具钢材供应商，也可以从德国、日本采购，但无国内替代供应商，对该类原材料存在重大进口依赖。未来，若公司与该等供应商合作关系发生不利变化，因国际关系等对国际贸易产生不利影响导致出现模具钢材和关键零部件断供，且替代的国产供应商供货不顺利，将可能对公司的生产经营产生不利影响。

3、境外销售的风险

公司塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备以出口为主，产品销往40余个国家。随着全球化竞争逐渐激烈，不排除部分国家和地区采取贸易保护主义政策。随着公司规模和业务的发展，未来公司外销收入的金额可能会进一步提升，而贸易政策的变化、国际贸易摩擦可能对公司的境外销售产生一定程度的不利影响。

4、产品质量风险

公司产品涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识的综合运用，下游客户对公司产品的质量要求较高，而公司产品的质量和性能受到原材料、设计、制造、售后服务等多种因素的影响，无法完全排除因不可控因素导致出现产品质量问题。如果公司在产品生产过程中管理控制不严格，出现产品性能不稳定或产品质量问题，可能影响客户的满意度甚至产生质量纠纷、客户流失，将可能对公司盈利水平产生一定的不利影响。

5、部分零部件外协加工的风险

公司产品所需的部分零部件存在外协加工。虽然公司制定了《外协控制程序》等外协管理流程、制度，但仍然无法直接控制外协供应商的交货时间和质量。若公司外协加工供应商不能按期、按质交货，将可能导致公司产品交货时间的延迟或者成本增加的不利局面，从而对公司的财务业绩和经营成果造成不利影响。

(三) 财务风险

1、业绩增长可持续性的风险

报告期公司营业收入8,991.05万元，去年同期公司营业收入14,349.69万元，同期下降37.34%，报告期内，公司所处的半导体封装设备受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司则存在业绩增长可持续性的风险。

2、毛利率下降风险

公司产品为服务于半导体塑料封装和塑料挤出成型领域的智能制造装备专用设备，具有定制化特征，毛利率对售价、产品结构、原材料价格等因素变化较为敏感。不同客户的产品配置、性能要求以及议价能力可能有所不同，相同客户在不同期间的订单价格也可能存在差异。若未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制、技术创新

优势等方面发生较大变动，或者行业竞争加剧，导致公司产品销售价格下降、成本费用提高或客户的需求发生较大的变化，公司将面临毛利率出现下降的风险。

3、应收账款风险

截止报告期末，公司的应收账款账面价值为9,100.74万元，占总资产的比例为8.30%。报告期内，公司的应收账款金额较大。半导体封装装备产品的主要客户均为国内头部或上市的半导体封装企业，总体信用状况良好。塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备主要以外销为主，发货前基本会收到90%以上的货款，应收账款余额较小。公司已根据谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。如果未来公司应收账款管理不当或者客户自身发生重大经营困难，可能导致公司应收账款无法及时收回，将对公司的经营业绩造成不利影响。

4、存货规模较大的风险

截止报告期末，公司存货账面价值13,523.76万元，占流动资产的比例分别为13.39%，主要为原材料、在产品、和发出商品。公司期末存货余额水平较高与公司产品主要为定制化智能制造设备以及下游客户的验收政策相关，设备从原材料采购到生产加工、出货至最终验收确认收入需要一定的周期，因此公司的原材料、在产品及发出商品随着业务规模扩张而增加。未来若市场环境发生重大不利变化、客户定制的设备产生大规模退货或原材料价格发生较大波动，公司存货将面临减值风险并可能产生较大损失，对公司的财务状况和经营成果产生负面影响。

5、汇率波动风险

报告期内，公司外销业务收入6,139.77万元，外销收入占同期主营业务收入的比例为70.44%，公司报告期内由于汇率变动而产生的汇兑损益。人民币汇率随着国际政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。随着公司业务规模的持续扩大，若未来人民币对美元、欧元和英镑的汇率发生剧烈波动，将对公司的业绩带来一定的不确定性，可能导致汇兑损失的产生，从而对公司的经营成果和财务状况造成不利影响。

6、税收优惠政策变化风险

报告期内，公司享受的税收优惠政策包括高新技术企业15%企业所得税税率优惠、出口销售的“免抵退”税收政策等，报告期税收优惠金额合计为707.90万元，占利润总额比重为27.01%。如果未来关于出口退税相关的法律法规、政策发生不利变化，或公司不

再符合高新技术企业的认定条件等情况，将可能对未来的经营业绩和现金流产生一定的不利影响。

7、净资产收益率下降的风险

截止报告期末，公司净资产余额为94,139.08万元。公司发行上市完成后，公司净资产规模在短时间内有较大幅度提高，而募集资金投资项目从建设到达产需要一定的时间，短期内公司净利润可能难以与净资产保持同步增长，公司存在净资产收益率下降的风险。

(四)行业风险

公司所处智能制造装备行业是国家重点支持的战略性新兴产业，主要产品为应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备，具体为半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备，其需求直接受到下游应用市场的影响。智能制造装备行业与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。如果全球及中国宏观经济增长大幅放缓，或行业景气度下滑，厂商的资本性支出可能延缓或减少，对装备需求亦可能延缓或减少，将给公司的短期业绩带来一定的压力。公司将积极开发国内外客户并且尽可能为客户提供高效的系统解决方案，同时加大对市场空间的拓展力度，以减缓行业风险对公司业务的冲击。

(五)其他重大风险

1、知识产权纠纷或诉讼风险

至报告期末，公司拥有有效的专利授权81项，其中发明专利31项、实用新型50项，另有软件著作权4项。各项专利技术和非专利技术等知识产权是公司核心竞争力的重要组成部分。如果出现公司知识产权遭到第三方侵害、因理解偏差而侵害第三方知识产权、第三方对公司知识产权提出纠纷或诉讼等情形，将对公司的生产经营和技术创新造成不利影响。

2、股权分散的风险

公司股权相对分散，目前无控股股东，公司实际控制人为黄明玖、郑天勤、吴成胜、徐劲风、胡火根五人组成的一致行动人，合计直接持有公司29.05%的股份。分散的股权结构可能导致公司存在决策效率降低的风险，进而对公司业务开展产生不利影响。此外，如果公司未来发生股权转让、定向增资、公开发行新股、一致行动人协议的有效期限届满后不再续签等情况，可能给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目是基于当前的国家产业政策、行业市场条件作出的。半导体封装装备新建项目及高端塑料型材挤出装备升级扩产项目达产后，公司将新增年产80台套自动封装设备（含模具）、80台套切筋设备（含模具）、400台套塑料挤出模具、挤出成型装置和50台套下游设备的生产能力。鉴于项目建设与产能释放需要一定时间，若国家产业政策发生变化，或因市场环境变化、行业竞争加剧、项目建设过程中管理不善都将会导致项目不能如期建成或不能实现预期收益，可能会出现产能利用率降低等对募投资项目产能消化不利的的影响，从而使公司面临募集资金投资项目实施风险。

先进封装设备研发中心项目的主要内容为新建厂房、购置研发专用设备、搭建研发平台等，不直接与研发项目挂钩，不直接产生效益。研发中心建成后的主要研发方向为先进封装设备，如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，导致先进封装设备开发及推向市场出现障碍，会对公司业绩产生不利影响。

4、其它风险

（1）股票价格波动风险

股票市场价格波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受宏观经济周期、利率、资金供求关系等因素的影响，同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。股票的价格波动是股票市场的正常现象。为此，公司特别提醒投资者必须具备风险意识，以便做出正确的投资决策。公司股票的市场价格可能会因多种因素而大幅波动，其中众多因素是公司无法控制的，主要包括：宏观经济波动、公司所处行业及相关行业上市公司的经营业绩及其预期、二级市场股票价格发生波动；证券分析师对公司业务的财务预测发生变动、持股建议发生变动或公司未能实现前述财务预测的估计；第三方研究机构关于半导体封装装备和挤出成型装备行业的预测发生变动；公司股东在二级市场上出售公司股票；中国股市整体及科创板的指数和成交量波动；客户、供应商、竞争对手、员工对公司提起的诉讼；涉及到公司专利的诉讼、争议或纠纷；中国证监会、上交所等监管机构的处置或调查；战争或恐怖主义行为等地缘政治事件等。综上，股票市场投资收益与投资风险并存，投资者对此应有充分准备。

（2）不可抗力风险

在公司日常经营过程中，无法排除因政治因素、自然灾害、战争在内的不可抗力事件对公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，从而对公司的生产经营造成不利影响。

四、重大违规事项

无。

五、主要财务数据及指标的变动原因及合理性

2023年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要财务数据	本报告期（1-6月）	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入（元）	89,910,541.55	143,496,902.82	-37.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,031,064.06	27,185,960.90	-15.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,508,892.32	24,220,694.06	-23.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,859,085.22	-7,147,152.45	不适用
归属于上市公司股东的净资产（元）	941,390,757.03	942,959,692.97	-0.17
总资产（元）	1,096,037,732.66	1,128,569,082.49	-2.88
主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	0.28	0.44	-36.36
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.44	-36.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.39	-41.03
加权平均净资产收益率(%)	2.43	13.73	减少 11.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.96	12.23	减少 10.27 个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	6.14	6.89	减少 0.75 个百分点

本报告期内，部分财务数据及指标的变动原因如下：

2023年1-6月份公司营业收入为8,991.05万元，同比下降37.34%，主要是半导体封装设备及模具收入下降。

2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额785.91万元，同比增长209.96%，主要是预收合同定金及政府补助增加所致。

2023年上半年基本每股收益0.28元，较上年同期下降36.36%，稀释每股收益0.28元，较上年同期下降36.36%，主要系净利润下降以及2022年11月公司上市股本增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益0.23元，较上年同期下降41.03%，主要原因是归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降以及 2022 年 11 月公司上市股本增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

公司主要从事智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的装备及系统解决方案。公司主要产品为应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备，具体为半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备，与国内及国际同行业企业的差别及核心竞争力体现的具体情况如下：

1、半导体封装设备及模具核心竞争力分析

序号	公司核心技术名称	核心技术描述
1	用于半导体芯片封装的树脂搬运技术	公司特有的二级顶出加大树脂运输行程, 扩大运用范围
2	半导体全自动封装设备移动预热台装置	引线框架加热台作为上料机械手一个组成部分, 减小热量损失
3	半导体可纠偏式模压塑封机	调整立柱张紧力而调整压机合模状态下的平行度
4	半导体全自动切筋成型设备的料盒（料盘）驱动装置	自动实现料盒（料盘）运输定位等机构
5	半导体全自动切筋成型设备的过载分离装置	公司独特的一种带缓冲和检测保护产品的推送机械手
6	半导体冲流道冲废塑模具	是气缸和伺服电机复合驱动完成冲切的机构
7	半导体封装成型压力计算技术	建立模型用程序实现计算
8	动态 PID (Proportion Integral Differential) 压力控制技术	公司独有的根据不同吨位动态调整 PID 控制参数的技术
9	windows 系统下 QT 和 MFC 应用程序间数据交互技术	实现跨平台 (Windows 和 Linux) 的数据共享技术
10	半导体全自动封装设备实时注塑压力曲线监控技术	对注塑压力进行实时处理和监控的技术
11	半导体全自动封装设备数据库连接及应用技术	一种安全可靠的数据库访问机制
12	高温状态下不同材料变形同步调节机构技术	几种材料热和力的作用下进行联合仿真后结构优化设计
13	DFN 产品型腔粗糙度加工技术	公司长期探索的大面积型腔的加工技术
14	超宽多排成型镶件加工技术	公司长期探索的微小面积型腔的加工技术
15	大面积封装合模压力在模面四个象限分别动态调整控制技术	晶圆级封装和板级封装时, 采用下活动合模台板四个象限的四个电机单独控制可调来进行动态补偿控制封装体厚度的技术
16	QFP 产品分离自动装盘技术	QFP 产品在切筋成型分离后经过阵列、收料机械手等步距变换之后才能排列到收料盘中的产品收盒技术
17	封装模具自动抽芯技术	IPM 智能功率模块封装成型模具中支撑型芯在熔

		体填充过程中实现自复位从而使框架或基板全方位包封保护的技术
18	薄膜辅助封装成型技术	该技术应用于大面积封装时有利于脱模和防止封装时溢胶，如芯片或散热片外露和防止框架非封装面的溢胶等，利用薄膜进行辅助封装的一种成型技术。该技术由一套独立的装置实现，包括脱模膜释放机构和收膜机构以及薄膜张紧机构等组成。
19	管脚矫正装置	该技术应用于对芯片切筋成型过程中存在芯片管脚变形的现象，为了保证生产的连续性和提供产品的合格率，对变形的管脚进行在线修正，实现对管脚位置的有效矫正，保证管脚位置的一致性，提高管脚在成型后释放内应力的均匀性，提高产品成型质量。
20	基于 MGP 模具的整模塑封条带自动投放抓取技术	基于 MGP 模具的全自动上下料结构，该结构集成了整模框架上料、整模塑封产品收料以及必要的相关检测等功能。

2、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备核心竞争力分析

序号	公司核心技术名称	核心技术描述
1	基于 Weissenberg-Robinowitsch 修正的 PowerLaw 非牛顿流体模型	经验数值和理论结合建立公司独有的数学模型
2	多腔高速挤出模具技术	公司独有的流道设计和定型冷却真空布局, 实现主型材 5-6 腔室挤出速度可达约 4.5-5m/min
3	共挤成型技术	公司独有的共挤流道设计, 实现多种不同材料的共挤
4	基于三维设计软件并面向挤出模具设计的二次开发平台技术	公司独有设计流程和方法用程序实现大部分自动生成
5	塑料型材无屑切割技术	公司独特切刀结构实现刀片在冷状态或热状态下都可以对型材或未成型的料饼切割
6	单壁型材及局部单壁冷却控制技术	公司独特的喷水控制结构, 确保对单壁型材及局部单壁形状进行柔性控制

如上表所述，公司通过十余年的技术创新与探索积累，在半导体封装设备及模具和塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备领域等方面具有核心技术，公司在现有核心技术的基础上不断进行延伸和其他新技术开发，积极提升技术储备，保持技术先进性。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	5,524,272.92	9,887,922.18	-44.13
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	5,524,272.92	9,887,922.18	-44.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.14	6.89	减少 0.75 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

(二) 研发进展

截至2023年6月30日，根据研发计划，全部在研项目按计划推进，公司目前在研项目8项，全部围绕公司主导产品技术提升和新品开发展开，涉及半导体封装相关产品开发7项，挤出成型装备基础性技术研究1项，其中基板粉末封装设备处于试验和测试阶段，封装设备PRO版NTAMS180PRO-V1、封装设备TO专机NTAMS120-TO正在进行研发样机装配，压缩成型封装设备NTCMS40-V1和J型切筋成型设备和模具处于设计阶段，高密度交叉SOT切筋成型设备和模具与FC封装成型模具两个项目已完成研发正在进行项目结题，挤出模头流道优化处于制造和装配阶段。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，公司向社会公开发行人人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币775,925,000.00元，扣除各项不含税的发行费用74,593,725.72元，实际募集资金净额为701,331,274.28元。该募集资金已于2022年11月2日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2023年半年度公司募集资金使用情况为：（1）本报告期直接投入募集资金项目525.10万元；（2）本报告期以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品54,600.00万元，理财产品到期赎回26,500.00万元。公司本报告期募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额132.82万元，截至2023年6月30日募集资金余额为68,633.27万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币49,300.00万元，募集资金专户余额合计为19,333.27万元。

项目	金额（万元）
----	--------

项目	金额（万元）
2022年12月31日募集资金专户余额	47,825.55
减：本报告期投入募集资金总额	525.10
其中：本报告期以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-
本报告期直接投入募集资金项目	525.10
减：本报告期以闲置资金购买理财产品	54,600.00
加：本报告期闲置资金购买理财产品到期赎回	26,500.00
加：本报告期收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	132.82
2023年6月30日募集资金余额	68,633.27
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	49,300.00
2023年6月30日募集资金专户余额	19,333.27

截至2023年6月30日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额（万元）
工行铜陵百大支行	1308020029200246657	7,702.48
工行铜陵百大支行	1308020029200246409	3,827.83
中国银行铜陵分行营业部	179769105890	7,492.93
中国银行铜陵分行营业部	188769100474	100.86
中国银行铜陵分行营业部	176769116940	209.17
合计	-	19,333.27

2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币67,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

受托人	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	投资收益（万元）	是否赎回
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	工行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第448期B款	11,200.00	2022-12-13	2023-6-30	1.4%-3.5%	-	是

受托人	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化收 益率	投资收 益(万 元)	是否 赎回
中国银行股份有限公司 铜陵分行营 业部	对公结构性存款 202225507	31,000.00	2023-1-3	2023-10-9	1.0%3.72%	-	否
中国工商银行股份有限 公司铜陵百 大支行	工行挂钩汇率区 间累计型法人人 民币结构性存款 产品-专户型 2022年第448期 B款	10,000.00	2022-12-13	2023-10-10	1.4%-3.5%	-	否
中国银行股份有限公 司铜陵分行营 业部	对公结构性存款 202225505	8,300.00	2023-1-3	2023-3-31	1.4%3.38%	67.05	是
中国银行股份有限公 司铜陵分行营 业部	对公结构性存款 202225506	7,000.00	2023-1-3	2023-6-30	1.4%-3.43%	47.79	是
中国银行股份有限公 司铜陵分行营 业部	对公结构性存款 202330990	8,300.00	2023-4-3	2023-9-30	1.4%-3.43%	-	否
合 计		75,800.00					

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为49,300.00万元。

2023年1-6月，公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事先审议额度的情形，但采用的是安全性高、流动性好的现金管理方式，现金管理产品符合相关募集资金管理规定，可获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，未影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司追认及增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。

除上述事项外，2023年1-6月，公司募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2023年6月30日，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	关系	直接持股比例 (%)	间接持股比例 (%)
1	黄明玖	实际控制人之一、董事长	4.86%	0.00%
2	郑天勤	实际控制人之一、董事、总经理	7.31%	0.26%
3	阮运松	董事	0.00%	6.37%
4	吴成胜	实际控制人之一、董事、副总经理、总工程师	5.49%	0.12%
5	胡火根	实际控制人之一	4.28%	0.12%
6	傅祥龙	董事	4.28%	0.00%
7	傅啸	监事会主席	0.00%	0.51%
8	江洪	监事	2.75%	0.00%
9	崔莹宝	监事	2.75%	0.00%
10	徐劲风	实际控制人之一、副总经理	7.11%	0.12%
11	黄戎	董事会秘书	0.00%	0.18%
12	王传伟	财务总监	0.00%	0.10%

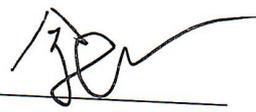
截至2023年6月30日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

(以下无正文)

(以下无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人:  
高震 余超

